

# Μικροσυστήματα και Νανοτεχνολογία Ασκηση

Διαδικασία κατασκευής τρανζίστορ

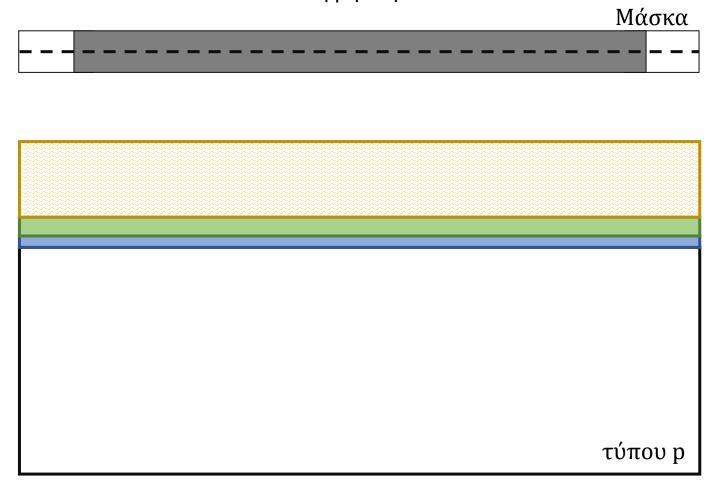
Ηλιόπουλος Γεώργιος 03118815 1. Ξεκινάμε με ένα wafer πυριτίου τύπου p. τύπου p 2. Οξείδωση για τη δημιουργία ενός λεπτού στρώματος  ${
m SiO}_2$ .  ${
m SiO}_2$ 

3. Εναπόθεση ενός λεπτού στρώματος  ${\rm Si}_3{
m N}_4$  για προστασία από περεταίρω οξείδωση.  ${\rm Si}_3{
m N}_4$ 

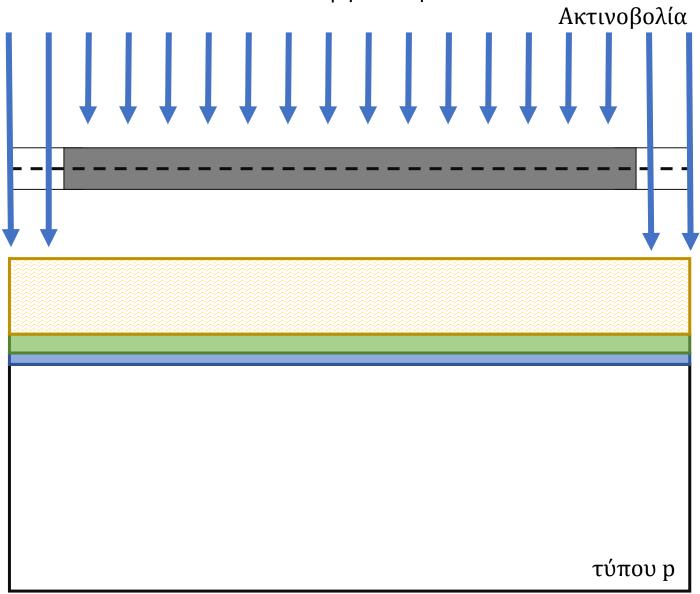
τύπου p

4. Κάλυψη επιφάνειας με ρητίνη για τη δημιουργία μάσκας.

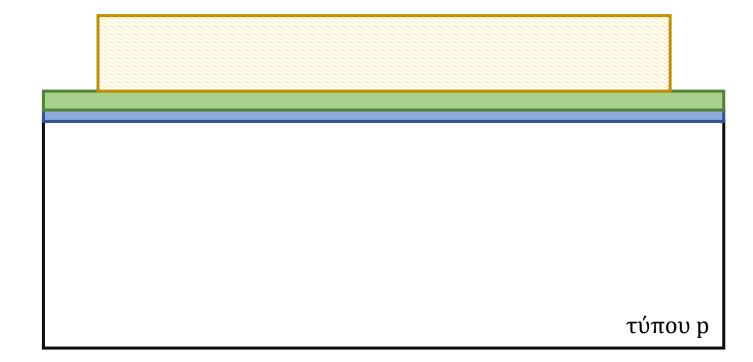
Photoresist τύπου p 5. Τοποθέτηση μάσκας με κενά στα σημεία όπου θέλουμε να φύγει η ρητίνη.



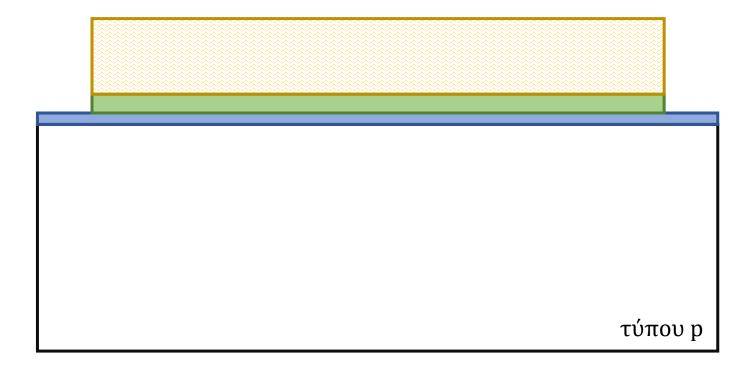
6. Ακτινοβόληση, τα σημεία που ακτινοβολήθηκαν έγιναν διαλυτά στον εμφανιστή.



7. Πέρασμα από τον εμφανιστή ώστε να φύγει η ακτινοβολημένη ρητίνη. Η ρητίνη λειτουργεί ως μάσκα στην εγχάραξη του νιτριδίου.



# 8. Ξηρή εγχάραξη νιτριδίου



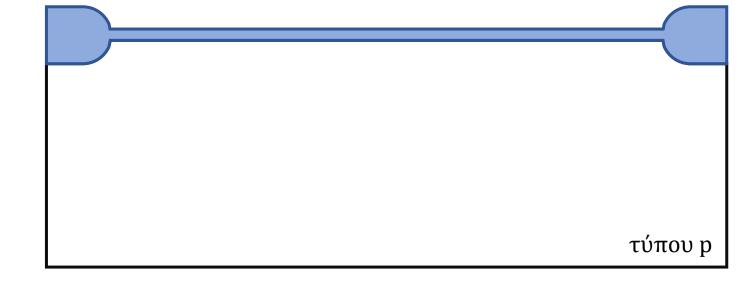
9. Απομάκρυνση ρητίνης.

τύπου p

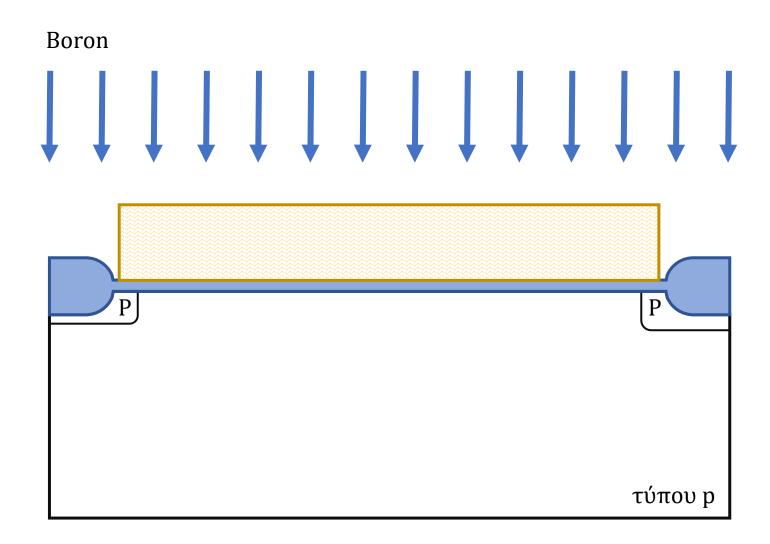
10. Επιπλέον οξείδωση με τη διαδικασία LOCOS.



11. Απομάκρυνση μάσκας νιτριδίου.



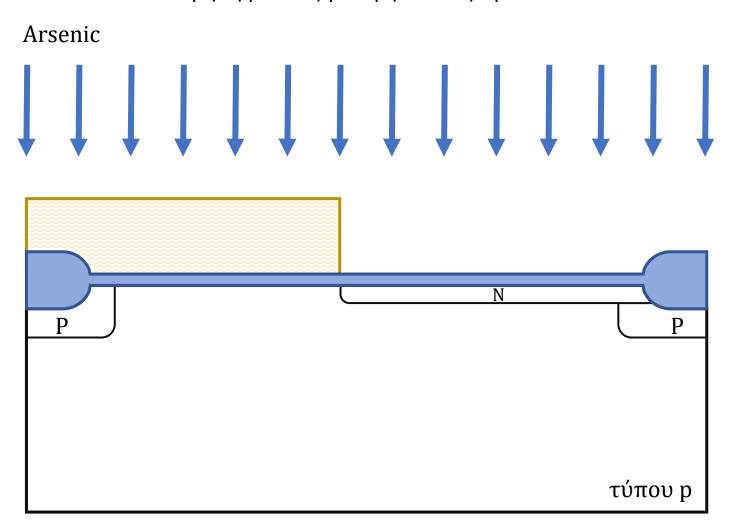
12. Χρήση μάσκας για εμφύτευση Βορίου στις ορισμένες περιοχές.



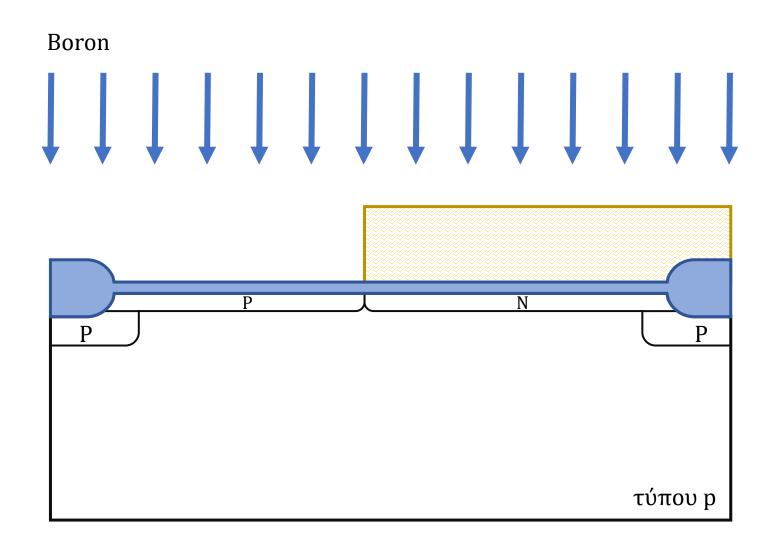
13. Θέρμανση για διάχυση Βορίου πιο βαθιά.



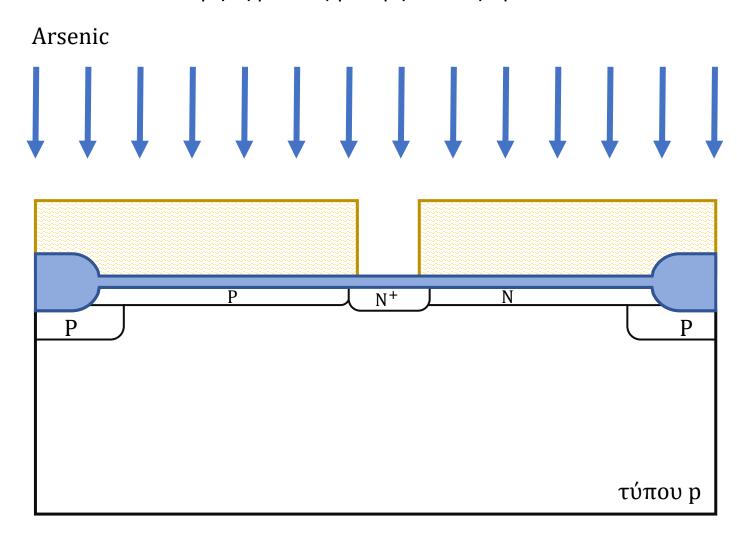
#### 14. Χρήση μάσκας για εμφύτευση Αρσενικού.



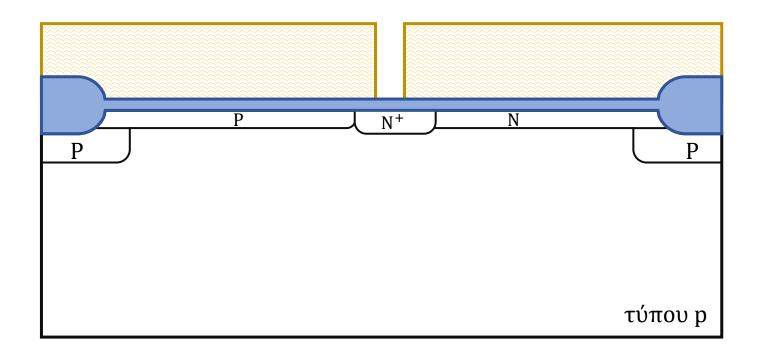
#### 15. Χρήση μάσκας για εμφύτευση Βορίου.



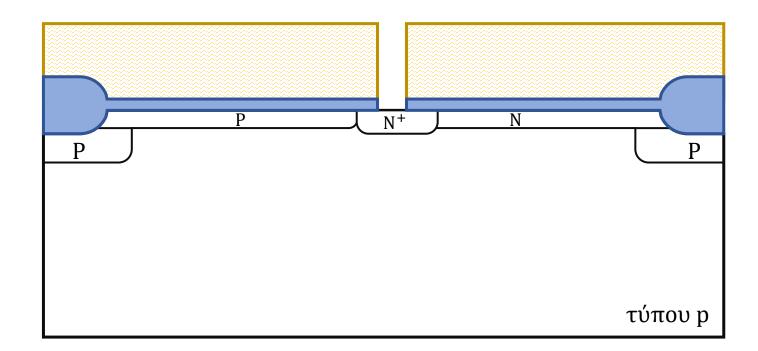
16. Χρήση μάσκας για εμφύτευση Αρσενικού.



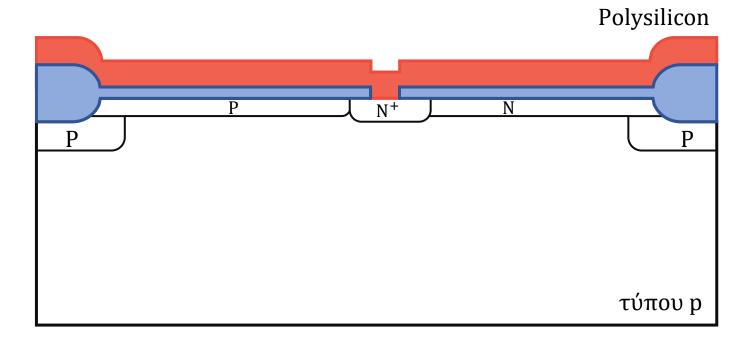
17. Δημιουργία μάσκας για εγχάραξη οξειδίου.



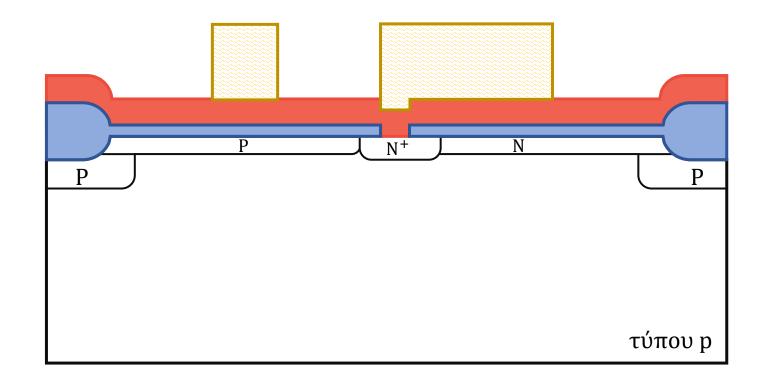
# 18. Εγχάραξη οξειδίου.



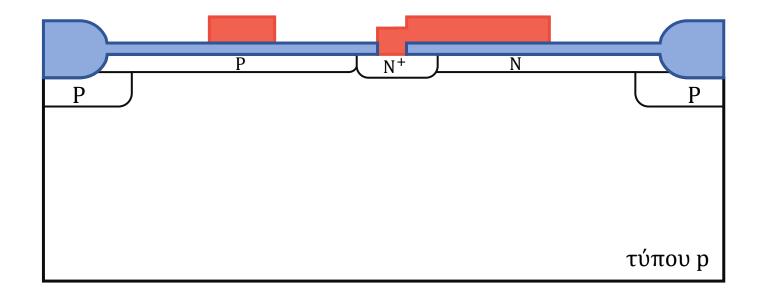
## 19. Εναπόθεση πολυπυριτίου.



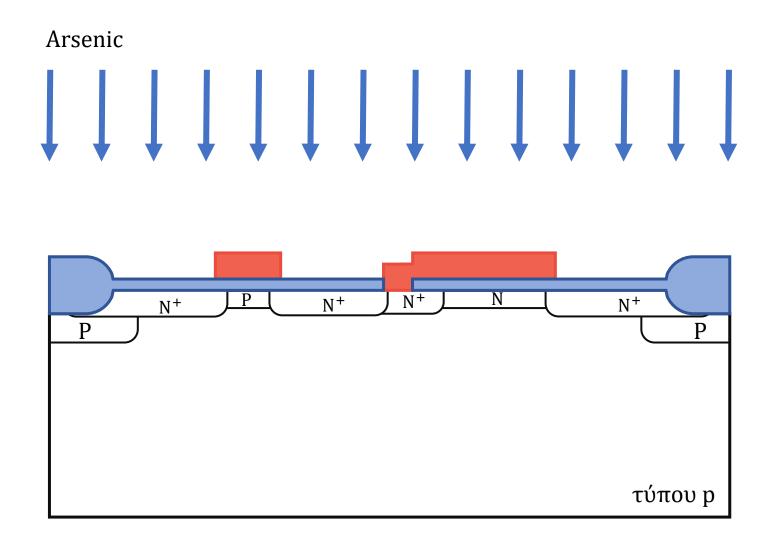
20. Δημιουργία μάσκας για εγχάραξη πολυπυριτίου.



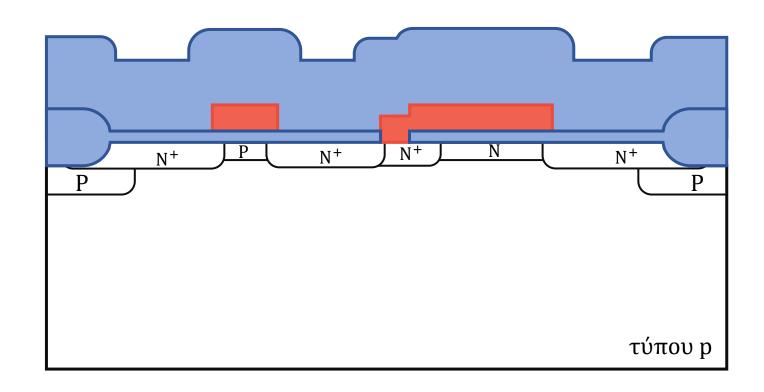
21. Πολυπυρίτιο μετά την εγχάραξη.



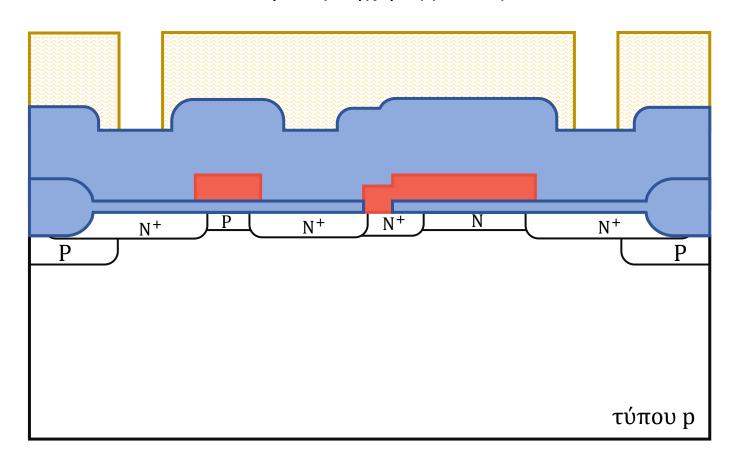
#### 22. Χρήση μάσκας για εμφύτευση Αρσενικού.



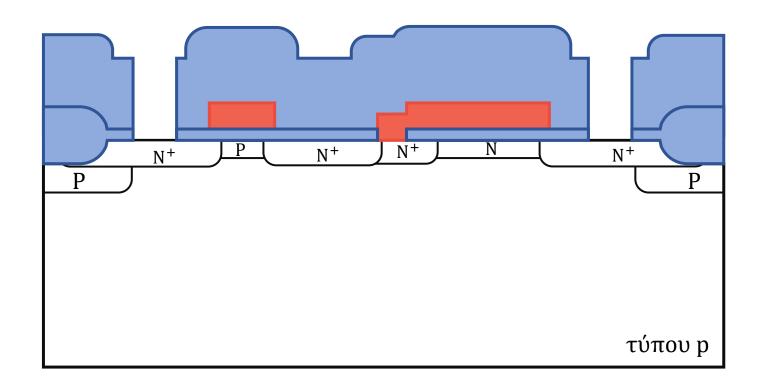
# 23. Οξείδωση.



## 24. Μάσκα για την εγχάραξη του οξειδίου.



# 25. Εγχάραξη του οξειδίου.



## 26. Επιμετάλλωση.

